

## 國家科學及技術委員會 函

地址：臺北市和平東路二段106號  
聯絡人：程稚茵  
電話：02-2737-7232  
傳真：02-2737-7619  
電子信箱：parker@nstc.gov.tw

受文者：長庚大學

發文日期：中華民國113年4月9日  
發文字號：科會產字第1130023573號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：

附件：2024未來科技獎徵件須知、「2024未來科技獎」暨參展報名資料表、2023未來科技獎獲選名單 (113T0P001325\_113D2009255-01.pdf、  
113T0P001325\_113D2009257-01.pdf、113T0P001325\_113D2009256-01.odt)

主旨：有關「2024台灣創新技術博覽會」辦理之未來科技獎徵件  
自即日起受理，請查照並轉知所屬踴躍報名。

說明：

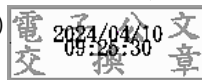
一、旨揭博覽會將於113年10月17日(四)至10月19日(六)於台北世貿一館展出，以成為國際研發交易樞紐平台為定位，由11大部會展示前瞻技術能量，並邀請海外機構參展，共同展現我國創新技術能量。

二、徵件說明如下(請詳附件徵選須知)：

三、本案聯絡窗口：陳小姐，電話：(02)2576-2013、信箱：  
wenhua@mail.tca.org.tw

正本：專題研究計畫受補助單位 (共298單位)

副本：中央研究院、教育部、衛生福利部(以上均含附件)、本會各處室及所屬機關(共26單位)、財團法人國家實驗研究院(含附件)、財團法人國家同步輻射研究中心(含附件)、國家災害防救科技中心(含附件)、國家太空中心(含附件)、台北市電腦商業同業公會(含附件)



主任委員吳政忠